



2026年6月29日

各 位

会社名 株式会社ジェイテックコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 津村 尚史
(コード番号：3446 東証スタンダード)
問合せ先 取締役 管理部長 日谷 哲也
(TEL. 072-655-2785)

表面加工・研磨装置（Plasma CVM及びPAP）受注のお知らせ

当社は本日、当社が次世代の表面加工・研磨加工装置として事業を進めておりますプラズマ化学的気相加工装置（Plasma CVM ※1）及びプラズマ援用研磨装置（PAP ※2）の受注を取得しましたので、お知らせします。

記

1. 受注内容

- (1) 納入先：水晶発振器及びダイヤモンドウェハ関連企業
- (2) 受注時期：2026年6月
- (3) 受注総額：約530百万円
- (4) 納入時期：PAPは2026年6月納入、Plasma CVMは2026年7月以降納入予定

なお、今回の受注内容、その他詳細な内容につきましては、受注相手先に対する営業秘密保護の必要性から非開示としております。

上記装置を中心に当社の表面加工技術について、各方面より多数のお問い合わせ・お引き合いを頂いており、今後も独自の表面加工・研磨技術及び装置の開発を推進、実用化へと展開を図ってまいります。

2. 今後の見通し

当社の長期成長戦略「Innovation2030」に掲げた目標を実現するため、各種半導体材料等の表面先端加工技術の実用化、高度化を図り、製品展開を推進することで企業価値向上に努めてまいります。

なお、当期納入のPAP案件は2026年6月期連結業績予想に織り込み済みであり、2026年7月以降の納入を予定しているPlasma CVM案件については来期以降の業績に与える影響を現在精査中です。

今後、開示すべき事象が発生した場合には、速やかに情報を開示いたします。

(参考)

※1. プラズマ化学的気相加工装置 (Plasma CVM) とは

生成AIの普及により需要の高まるデータセンター処理能力や通信ネットワークの高速化が必要とされ、その中に組込まれる水晶発振器の高精度化に注目が高まっており、これを実現するためには、水晶ウェハの超精密な厚み加工を実現する必要があります。

しかしながら従来加工方式では数百ナノメートルの精度までしか達成できませんでした。

そこで当社では、ウェハ上に局所的に反応性ガスプラズマを発生させ、更にNC制御によりウェハ全面を均一に加工する独自方式のPlasma CVMにより、数ナノメートルレベルの高精度精密加工を実現しており、本方式を用いた量産システム(図1参照)を販売しております。



加工中のプラズマ発生状態

図1. プラズマ化学的気相加工 (Plasma CVM) 量産システム外観

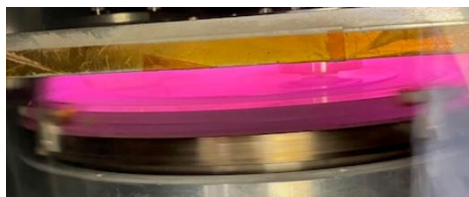
※2. プラズマ援用研磨装置 (PAP) とは

データセンター処理や通信ネットワークの高速化、更に各市場で需要拡大が進んでいるパワー半導体の市場で課題となる熱処理の問題で、高い物理特性を持つダイヤモンドが、放熱素子(ヒートシンク)やデバイス基板ウェハ用途として注目されております。

しかしながらダイヤモンドの特性を生かし高効率な熱伝導コンポーネントを実現する為には、ウェハの表面を非常に滑らかにかつ表面ダメージのない加工が必要であり、従来の機械的接触加工方式では、サブナノメートルの面粗さを達成するために、非常に長時間の加工タクトを必要とし、微小クラックや加工変質層が残り、デバイス特性に悪影響おりました。

そこで当社では、反応性ガスプラズマによって機械的負荷を極小化する独自方式のPAPでは、数時間でサブナノメートルレベルの高精度表面とダメージレス研磨を実現します。

現在ダイヤモンド半導体市場は、揺籃期から成長期に移行しつつあり、ダイヤモンド半導体業界の顧客の要望は多岐にわたっております。当社はこの多様化するニーズに応えるため、各社と積極的に共同開発を推進し、本方式を用いた製品(図2参照)を販売しております。



加工中のプラズマ発生状態



図2. プラズマ援用研磨装置 (PAP) 外観

以 上